

Запропоновано клейове з'єднання та чіп-картку, виготовлену за допомогою клейового з'єднання. Клейове з'єднання клейовим шаром (V) з'єднує деталь (1) з першого матеріалу з пластмасовою деталлю (5), причому клейовий шар (V) має багатшарову структуру і складається з еластичного основного шару (4), виготовленого з акрилату, і прилеглих до першої деталі (1) і пластмасової деталі (5) приповерхневих шарів (2), виготовлених з клею гарячого тверднення. Між кожним приповерхневим шаром (2) і основним шаром (4) розміщені перехідні шари (3). Чіп-картка складається із напівпровідникового модуля і корпусу картки, з'єднаних між собою запропонованим клейовим з'єднанням.